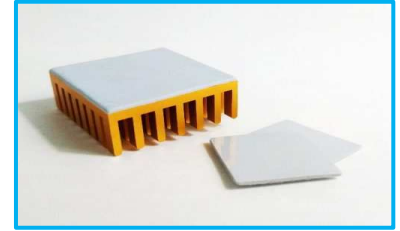


Nos Mousse Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs **non siliconné** qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_030_R_NS est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement faible est demandé. En effet, celui-ci est un BON conducteur thermique de 3W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. Nous pouvons découper selon plan client. Tous nos matelas sont certifiés UL 94 en V0.

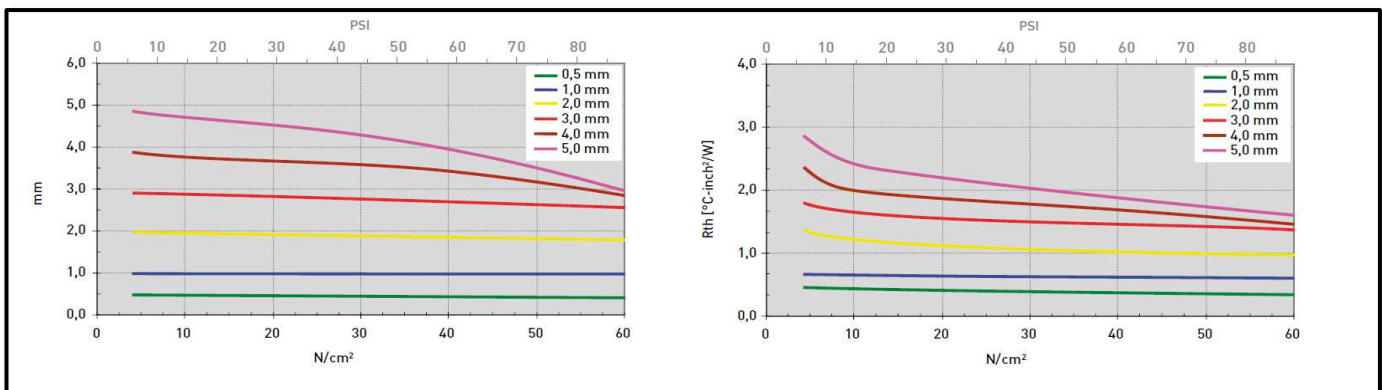


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unit	TGF_030_R_NS			
		0.5	1	2	3
Epaisseur	mm	0.5	1	2	3
Gravité Spécific	g/cm ³	2.9			
Couleur	-	Blanc			
Dureté	Shore 00	70			
Taille	mm	400*200			
Résistance @60 Psi	°C-inch ² /W (mm)	0.38 (0.44)	0.63 (0.97)	1.03 (1.85)	1.47 (2.71)
Résistance @30 Psi		0.42 (0.46)	0.64 (0.98)	1.12 (1.85)	1.57 (2.81)
Résistance @10 Psi		0.45 (0.47)	0.65 (0.99)	1.25 (1.96)	1.72 (2.88)
Conductivité thermique	W/mK	3			
Température	°C	-40 to 130			
Tension de claquage	kV/mm	7.8			
Résistance volumique	Ohm - cm	1 x 10 ¹¹			
Contante dielectric	@1MHz	-			

Le TGF_030_R_NS est disponible en 0.5/1/2/3/4/5mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.